

Arrêté du 25 novembre 2005 fixant les cas et conditions dans lesquels l'utilisation dans les équipements électriques et électroniques de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles ou de polybromodiphényléthers est autorisée

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive n° 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 modifiée relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre 1er et le chapitre 1er du titre IV de son livre V ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le décret n° 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination ;

Vu le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, notamment son article 4,

Arrêtent :

Article 1

Les matériaux homogènes utilisés dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché à compter du 1er juillet 2006 ne contiennent pas plus de 0,1 % en poids de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) et de polybromobiphényléthers (PBDE), et pas plus de 0,01 % en poids de cadmium.

Article 2

L'utilisation de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles ou de polybromodiphényléthers dans les équipements électriques et électroniques mentionnés à l'article 1er du décret du 20 juillet 2005 susvisé est autorisée pour les usages mentionnés à l'annexe du présent arrêté.

Ces substances peuvent en outre être utilisées dans les piles et accumulateurs faisant partie intégrante de l'équipement électrique et électronique dans les conditions prévues par le décret du 12 mai 1999 susvisé.

Article 3

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 2005.

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,
de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

L. Rousseau

A N N E X E

USAGES POUR LESQUELS L'UTILISATION DE PLOMB, DE MERCURE, DE CADMIUM, DE CHROME HEXAVALENT, DE POLYBROMOBIPHÉNYLES ET DE POLYBROMODIPHÉNYLÉTHERS EST AUTORISÉE

1. Le mercure dans les lampes fluorescentes compactes lorsque sa masse ne dépasse pas 5 milligrammes par lampe.

2. Le mercure dans les tubes fluorescents classiques à usage général lorsque sa masse ne dépasse pas :

- pour les tubes halophosphate : 10 milligrammes par lampe ;
- pour les tubes triphosphore à durée de vie normale : 5 milligrammes par lampe ;
- pour les tubes triphosphore à durée de vie longue : 8 milligrammes par lampe.

3. Le mercure dans les tubes fluorescents classiques pour usages spéciaux.

4. Le mercure dans les autres lampes non spécifiées dans la présente annexe.

5. Le plomb dans le verre des tubes cathodiques, des composants électroniques et des tubes fluorescents.

6. Le plomb en tant qu'élément d'alliage avec l'acier lorsque la concentration massique de plomb ne dépasse pas 0,35 %, avec l'aluminium lorsque la concentration massique de plomb ne dépasse pas 0,4 % et dans les alliages de cuivre lorsque la concentration massique de plomb ne dépasse pas 4 %.

7. Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c'est-à-dire dans les alliages de plomb contenant au moins 85 % en poids de plomb).

Le plomb dans les soudures pour les serveurs, les systèmes de stockage et de matrices de stockage.

Les équipements d'infrastructure de réseaux destinés à la communication, la signalisation, la transmission ainsi qu'à la gestion de réseaux dans le domaine des télécommunications.

Le plomb dans les composants électroniques en céramique (par exemple les dispositifs piézo-électriques).

8. Le cadmium et ses composés dans les contacts électriques et pour le cadmiage, sauf pour les applications interdites par le décret n° 94-647 du 27 juillet 1994 relatif à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du pentachlorophénol, du cadmium et de leurs composés.

9. Le chrome hexavalent comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption.

10. Le décabromodiphényléther dans les applications polymérisées.

11. Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets en plomb/bronze.

12. Le plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes.

13. Le plomb en tant que matériau de revêtement pour l'anneau en C du module thermoconducteur.

14. Le plomb et le cadmium dans le verre d'optique et le verre filtrant.

15. Le plomb dans les soudures comportant plus de deux éléments pour la connexion entre les broches et le boîtier de microprocesseurs, à teneur en plomb comprise entre 80 et 85 %

en poids.

16. Le plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semiconducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée